

Title (en)
COPPER PROFILE, DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING A COPPER PROFILE

Title (de)
VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES KUPFERPROFILS, KUPFERPROFIL UND VORRICHTUNG

Title (fr)
PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN PROFILÉ DE CUIVRE, PROFILÉ DE CUIVRE ET DISPOSITIF

Publication
EP 3382066 A1 20181003 (DE)

Application
EP 18164144 A 20180327

Priority
DE 102017107007 A 20170331

Abstract (de)
Verfahren zum Herstellen eines Kupferprofils aus einem Kupferausgangsmaterial, insbesondere eines Kupferdrahtes, mit folgenden Schritten
- elektrolytisches Reinigen des Kupferausgangsmaterials, wobei das Kupferausgangsmaterial in einem kupferhaltigen Elektrolyt in einem Elektrolytbad mit mindestens einer Elektrode eingebracht wird, die Elektrode mittels einer Spannungsversorgung polarisiert wird und das Kupferausgangsmaterial über den Elektrolyten polarisiert wird, so dass das Kupferausgangsmaterial frei von einer direkten Spannungsversorgung ist, und
- Strangpressen des elektrolytisch gereinigten Kupferausgangsmaterials durch eine Formmatrize, sodass das Kupferprofil vorliegt. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Kupferprofil und eine Vorrichtung zum Herstellen eines Kupferprofils.

IPC 8 full level
C25F 1/04 (2006.01); **B21C 23/08** (2006.01); **C25D 7/06** (2006.01)

CPC (source: EP)
B21C 23/08 (2013.01); **B21C 43/00** (2013.01); **C25D 3/38** (2013.01); **C25D 5/34** (2013.01); **C25D 7/0607** (2013.01); **C25D 17/00** (2013.01); **C25F 1/04** (2013.01); **C25F 7/00** (2013.01)

Citation (applicant)
• US 5516408 A 19960514 - BURGESS DAVID P [US], et al
• DE 69422715 T2 20000831 - DURACELL INC [US]

Citation (search report)
• [XA] DE 102007034096 A1 20090122 - UMICORE AG & CO KG [DE]
• [A] WO 2015091854 A2 20150625 - SCHLENK METALLFOLIEN GMBH & CO KG [DE], et al
• [A] EP 0518850 A1 19921216 - ANDRITZ PATENTVERWALTUNG [AT]
• [A] US 4492615 A 19850108 - LEFEBVRE JACQUES [FR]

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3382066 A1 20181003; EP 3382066 B1 20210505; DE 102017107007 A1 20181004; ES 2879227 T3 20211122; PL 3382066 T3 20211102

DOCDB simple family (application)
EP 18164144 A 20180327; DE 102017107007 A 20170331; ES 18164144 T 20180327; PL 18164144 T 20180327